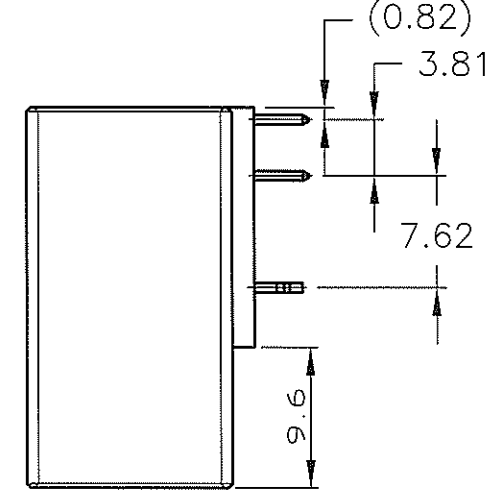
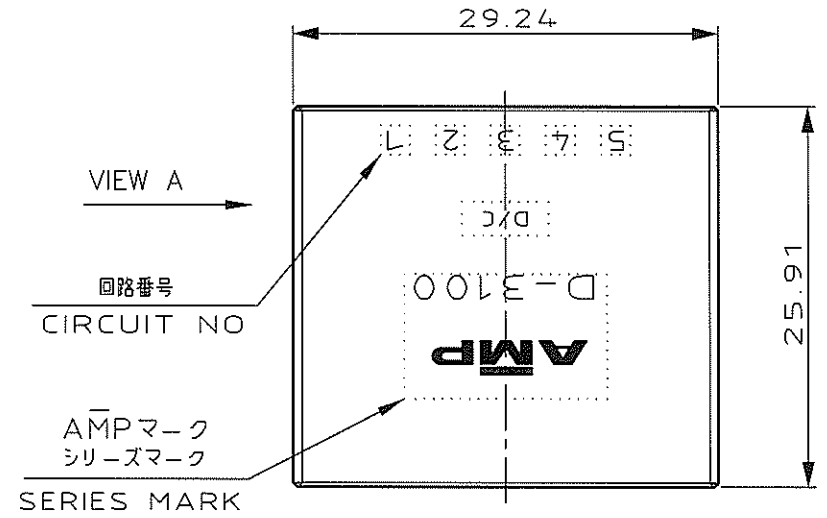
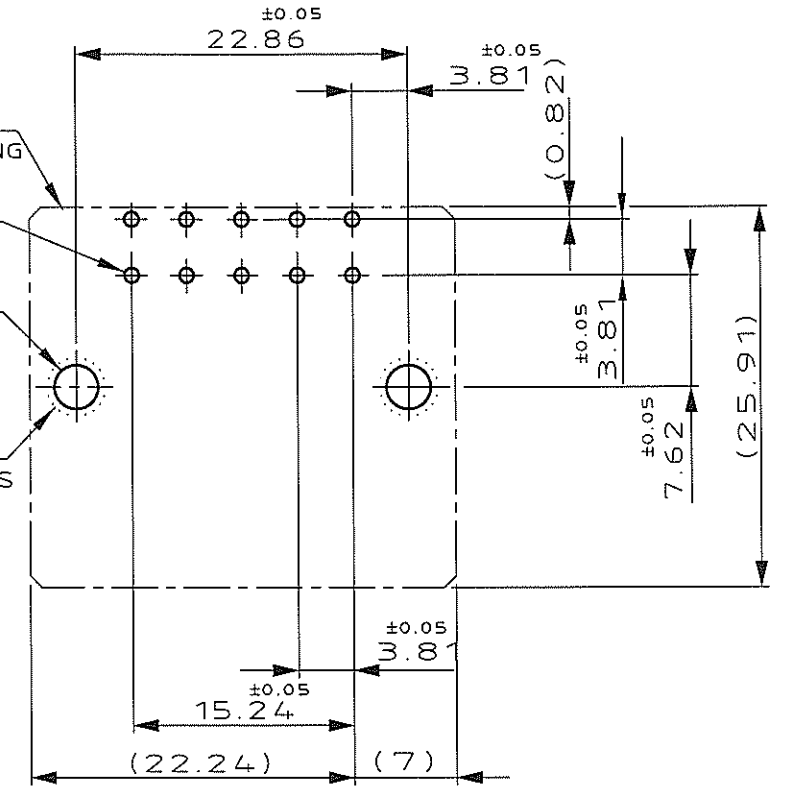


NUMBER 178305  
 METRIC  
 DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT  
 PRINT DIST

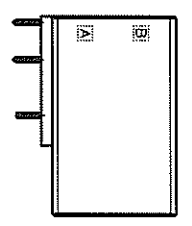
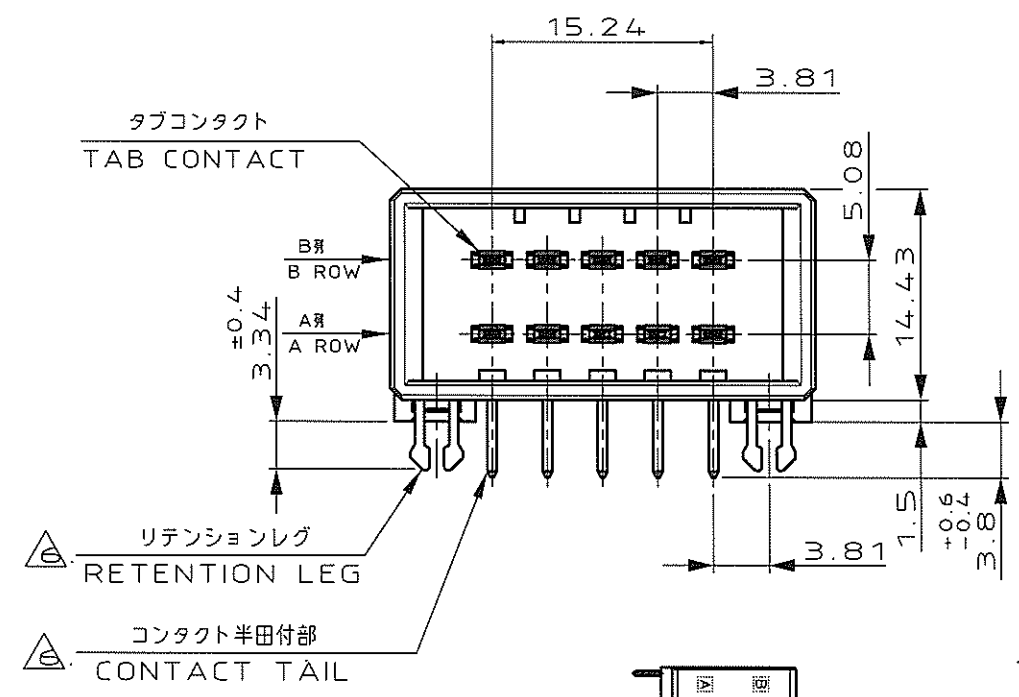


コネクタ外形  
 OUTLINE OF HEADER HOUSING  
 10-φ1.1 ±0.1  
 DIA 1.1±0.1 10 PLACES  
 スルーホール 2-φ3 ±0.1  
 DIA 3±0.1 2 PLACES  
 ラウンド 2-φ4 MIN  
 ROUND DIA 4 MIN 2 PLACES



推奨基板取付け寸法  
 PC 基板厚: 1.6±0.1  
 (非累積公差)  
 (コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN  
 PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1  
 (NOT ACCUMULATE TOLERANCE)  
 (CONNECTOR MOUNT SIDE)



NOTES

- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER  
 CONTACT: COPPER ALLOY  
 RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注記

- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂  
 コネクタ: 銅合金  
 リテンションレグ: 銅合金
- めっき: コネクタ: 全面Ni下地  
 接触部: 0.38 μm MIN 金めっき
- めっき: コネクタ: 全面Ni下地  
 接触部: 0.76 μm MIN 金めっき
- めっき: コネクタ: 全面Ni下地  
 接触部: 2.0 μm MIN スズめっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部  
 ニッケル下地の上に半田めっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部: ニッケル下地の上にスズめっき

△6	△4	178305-5
△5	△3	178305-3
△6	△2	178305-2
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)

C2	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	25APR11
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE

WIRE RANGE		INSULATION DIA	NAME	
mm²(AWG)		mm	ダイナミック D3100 水平タイプ 10 極 ヘッダーアセンブリー	
MATERIAL		FINISH	10 POS DOUBLE ROW HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC 3100	
SEE NOTE 注記参照		SEE NOTE 注記参照	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	SIZE LOC NUMBER
DR. 14 JUN 91 N. Matsubara		DE. 14 JUN 91 N. Matsubara		A3 J C-178305
CHK. 24/FEB/92 H. Oota		APP. L/MAR/92 S. MANABE		SCALE REV. SHEET
		100% ±0.3 30% ±0.4 30% ±0.45 角 度 ±3'		2-1 C2 1 OF 1



单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>TE Connectivity\(泰科\)](#)